

Title (en)

Method for sealing a structural panel

Title (de)

Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff

Title (fr)

Procédé de scellement d'une plaque de construction

Publication

EP 2098304 A2 20090909 (DE)

Application

EP 09007035 A 20040901

Priority

- EP 04020746 A 20040901
- DE 10341172 A 20030906

Abstract (en)

The method involves applying a liquid resin i.e. melamine resin, on a top side of a construction plate that is made of wood or wood material. The resin is dried, and the plate is pressed under the influence of temperature so that the resin partially melts. The resin is applied in multiple layers and each layer is dried before the next is applied. The resin is stained. A color layer is applied on the top side or on a bottom side under or between the resin layers. Corundum is mixed into or scattered onto the resin layer. The sealing is performed simultaneously on the top and the bottom sides.

Abstract (de)

Es wird ein Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff mit einer Oberseite und einer Unterseite mit folgenden Schritten vorgeschlagen: a) Auftragen von flüssigem Harz auf die Oberseite, b) Trocknen des Harzes, c) Verpressen der Bauplatte unter Temperatureinfluss, wobei das Harz zumindest teilweise schmilzt. d) Einprägen eines zu der Holzmaserung korrespondierenden Reliefs.

IPC 8 full level

B05D 7/06 (2006.01); **B05D 3/02** (2006.01); **B05D 3/12** (2006.01); **B27M 3/04** (2006.01); **B27N 7/00** (2006.01); **E04F 13/10** (2006.01); **E04F 15/04** (2006.01); **E04G 9/04** (2006.01); **B05D 1/40** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B05D 3/0254 (2013.01 - EP US); **B05D 3/12** (2013.01 - EP US); **B05D 7/06** (2013.01 - EP US); **B27M 3/04** (2013.01 - EP US); **B05D 1/40** (2013.01 - EP US); **B05D 2252/10** (2013.01 - EP US); **B05D 2601/20** (2013.01 - EP US); **E04F 15/02** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

- EP 0560870 B1 19960320 - AHO JYRKI [FI], et al
- DE 3735368 C2 19910718

Cited by

EP2730430A1; WO2014072051A1; US9802222B2; EP2338693A1; WO2011076305A1; US8512804B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1512468 A2 20050309; **EP 1512468 A3 20060405**; **EP 1512468 B1 20091007**; AT E444815 T1 20091015; DE 10341172 A1 20050407; DE 10341172 B4 20090723; DE 10362218 B4 20100916; DE 502004010191 D1 20091119; EP 2098304 A2 20090909; EP 2098304 A3 20091209; EP 2098304 B1 20130227; ES 2331796 T3 20100115; PL 1512468 T3 20100331; PL 2098304 T3 20130830; US 2005089644 A1 20050428; US 8003168 B2 20110823

DOCDB simple family (application)

EP 04020746 A 20040901; AT 04020746 T 20040901; DE 10341172 A 20030906; DE 10362218 A 20030906; DE 502004010191 T 20040901; EP 09007035 A 20040901; ES 04020746 T 20040901; PL 04020746 T 20040901; PL 09007035 T 20040901; US 93233704 A 20040902